

Infineon Technologies Eckdaten

Firmensitz:	München
Regionale Niederlassungen:	Nord-, Mittel-, Südamerika: San Jose, Kalifornien Asien-Pazifik: Singapur Japan: Tokio
Umsatz im Geschäftsjahr 2001: (30. September 2001)	5,67 Milliarden Euro
Mitarbeiter (September 2001):	Weltweit etwa 33.800
Marktposition 2000:	Weltweit unter den Top-10-Halbleiterherstellern (nach Umsatz; Quelle: Dataquest, Status 12/2000)
Aktivitäten:	Chips für drahtlose Kommunikation (Nr. 1 bei High-Frequency-Komponenten) Kommunikations- und Multimedichips (Nr. 1 bei ISDN) Automobil- und Industrieelektronik (Nr. 2 im Automobilbereich ohne Autoradio) ICs für Sicherheits- und Chipkartenanwendungen (Nr. 1 im Chipkartensegment) Speicherbausteine (Nr. 1 in 300-Millimeter-Technologie, Nr. 4 im DRAM-Markt)

Fertigung: Neun Wafer-Produktionsstätten (Frontend-Fabs), u.a. modernste DRAM-Fertigung auf drei Kontinenten (Europa, USA, Asien)
13 Produktionsstätten für Montage und Test (Backend)

Entwicklung: 29 Forschungs- und Entwicklungszentren für markt- und kundenorientierte Entwicklung in neun Ländern

F&E-Aufwendungen im Geschäftsjahr 2001: 1,19 Milliarden Euro (21 Prozent des Umsatzes)

Strategische Partnerschaften: IBM
(Technologieentwicklung, Fertigungs-JV in Frankreich)
UMC
(Technologieentwicklung für die Herstellung von Logikprodukten; Fertigungs-JV in Singapur)
Mosel Vitelec
(Fertigungs-JV in Taiwan für Speicherbausteine)
Toshiba
(Technologieentwicklung)

Börsenkürzel: Unter IFX als DAX-Unternehmen an der Frankfurter Börse und der New York Stock Exchange notiert

Weitere Informationen unter www.infineon.com